



创 容 新 能 源

承 认 书

(APPROVE SHEET)

TO: 谐振薄膜电容 82nF $\pm$ 5% 630V

主要材料		印字样式及成品图
组 件	材料名称	
内 部 结 构	双面金属化薄膜	
导 线	镀锡铜包钢线	
灌封料	阻燃灰色环氧树脂	
外 壳	阻燃灰色外壳	

料 号	规 格	成品尺寸（mm）						备注
		W	H	T	P	L	D	
RS3044	MKP-RS823J630V	18	14.5	8.5	15	15	0.8	
额定容量	0.082 μ F	容量偏差				±5%		
额定电压	630V.DC							
承认回签时请在下面填写贵司料号								

客户签承栏			创容承办栏		
核准	检验	承认签章	核准	审核	拟制
				袁新强	李爱
日期			日期	2021-03-19	

深 圳 市 创 容 新 能 源 有 限 公 司

SHENZHEN CREATE START INDUSTRIAL LIMITED

深圳市宝安区松岗街道燕川社区北部工业园研发中心 6 楼 7 楼

TEL: 0755—29948883 29948998 FAX: 0755—29948906 [http://:www.csdcap.com](http://www.csdcap.com)

CXE-07BD-08

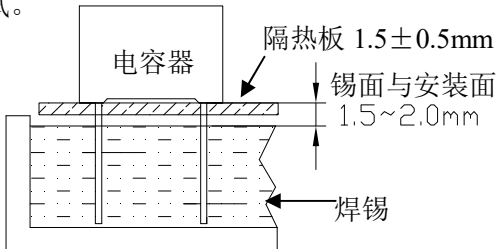
电容器使用范围

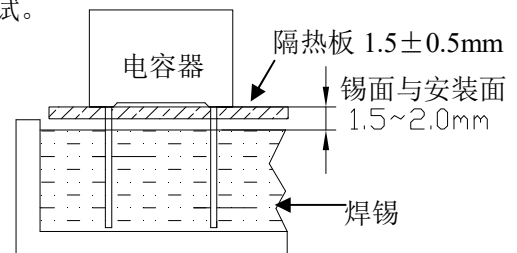
项次	项目	使用条件	使用范围	
1	使用温度范围	最高使用温度	105℃	
		额定温度	85℃	
		最低使用温度	-40℃	
2	使用电压范围	环境温度	使用电压	
		环境温度≤85℃	使用电压≤1.0*额定电压（连续）	
		环境温度＞85℃	环境温度每增加一度额定电压下降 1.25%	
4	可焊性	焊锡温度（加助焊剂）	235±5℃	焊接方式如耐焊接热图要求
		焊锡时间	2±0.5 秒	如因焊接过程不符合我司焊接要求导致电容器芯子收缩,爆裂,性能下降,所引起电容器爆炸,容量衰减等不良现象。我司概不负责。

电容器试验规范

测试标准条件：1.温度 15~35℃；2.湿度 45~75%；3.大气压 86~106 千帕

（如有争议时，测试标准条件：1.温度 20 $\pm$ 1℃；2.湿度 63~67%；3.大气压 86~106 千帕）

项次	项目	标准		测试要求			
1	静电容量(C_S)	符合规定静电容量误差		温度 $20\pm 1^{\circ}\text{C}$; 频率 $10\pm 0.1\text{kHz}$; 电压 $\text{rms}1\pm 0.1\text{V}$			
2	损耗角正切 (DF)	DF ≤ 0.0010					
3	耐电压	电极间	加压时允许自愈	1.5 * V_R (DC) 5S			
		极壳间	无击穿或飞弧	2* V_R			
4.	绝缘电阻	$C_R>0.33\mu\text{F}$	$\geq 5000\text{ M}\Omega\cdot\mu\text{F}$	电压 $100\pm 15\text{VDC}$; 时间 60S; 温度 $20\pm 1^{\circ}\text{C}$			
		$C_R\leq 0.33\mu\text{F}$	$\geq 15000\text{M}\Omega$				
5	耐久性试验	电容量		变化率 $\leq 10\%$		电压 1.25* V_R ; 时间 1000 小时; 温度 105°C ; (每颗电容器串联一颗 $47\Omega\pm 5\%$ 电阻)	
		DF	$C_R\leq 1\mu\text{F}$	DF ≤ 0.004			
			$C_R> 1\mu\text{F}$	DF ≤ 0.005			
		耐电压		加压时允许自愈			
		绝缘电阻		>4 项中相对应极限值的 50%			
		外观检查		无可见损伤			
6	耐焊接热	电容量变化率	变化率 $\leq 10\%$	焊槽温度	$260\pm 5^{\circ}\text{C}$	焊接时间	≤ 5 秒
		外观检查	无可见损伤	如图焊接后在测试标准条件中放置 1~2 小时后再测试。 			

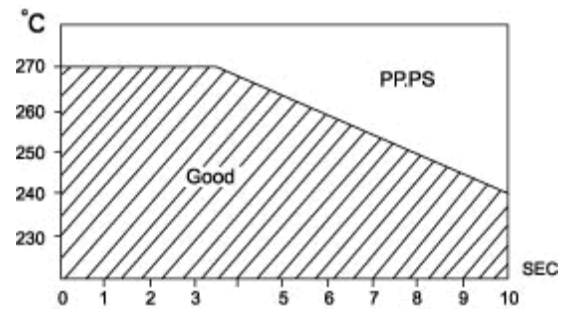
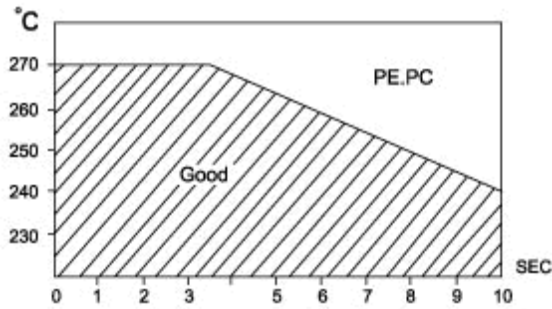


注意：如因客户测试和使用超出我司以上要求范围，我司概不负责。

薄膜电容性能参数

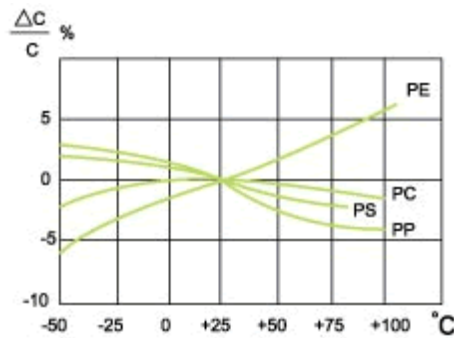
1. 焊接温度与时间对比

Soldering Temperature VS Time

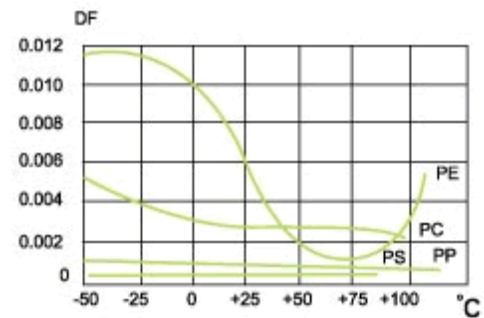


2. 温度性能

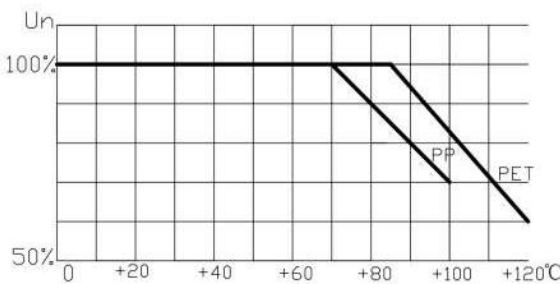
Temperature Characteristics



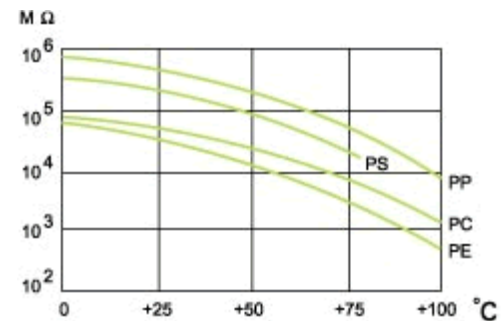
容量变化率与温度的关系



损耗角正切与温度的关系



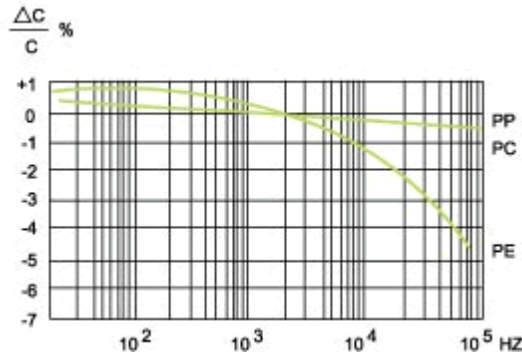
使用电压与温度的关系



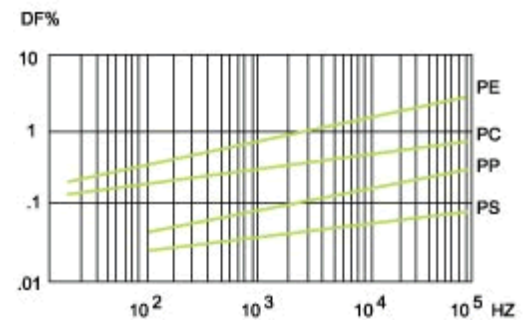
绝缘电阻与温度的关系

3. 频率性能

Frequency Characteristics



容量变化率与频率的关系



损耗角正切与频率的关系